

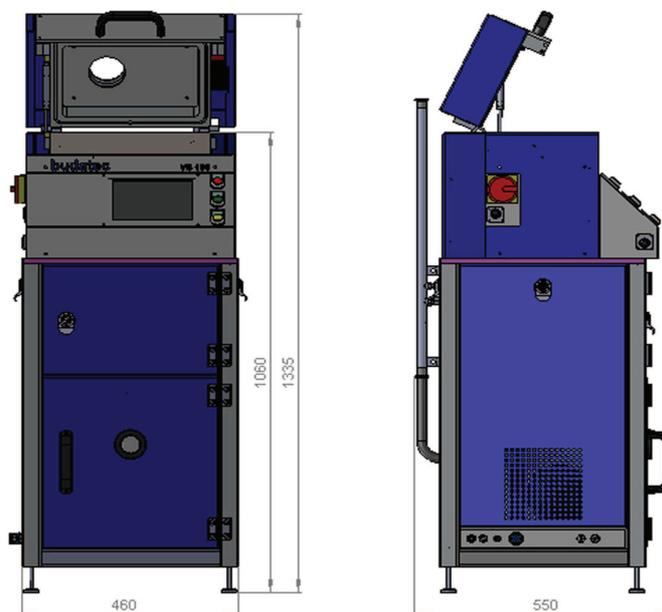
VS 160UG Vacuum Soldering System



budatec

Equipment for semiconductor and photovoltaics industries

Габаритные размеры:



Технические характеристики:

| | |
|---|--|
| Размер нагревательной поверхности | 160мм x 160мм |
| Макс. высота компонентов | 50мм |
| Макс. температура пайки | 450°C |
| Скорость нагрева и охлаждения | Макс. 3 К/сек |
| Макс. загрузка нагревательной поверхности | 2,5кг |
| Рабочие газы | N ₂ ; N ₂ H ₂ 95/5% |
| Электропитание | 400В/16А |
| Подключение системы охлаждения водой | 10 л/мин |
| Вес печи | ~ 80 кг |

Опциональное оснащение:

| |
|---|
| Измерение абсолютного давления |
| Пластинчатый насос с комплектующими |
| Программное обеспечение для записи данных |
| Подставка с подводом рабочих газов и возможностью размещения насоса |
| Газовая линия HCOOH с интегрированным барботером |

budatec GmbH
www.budatec.de

info@budatec.de